

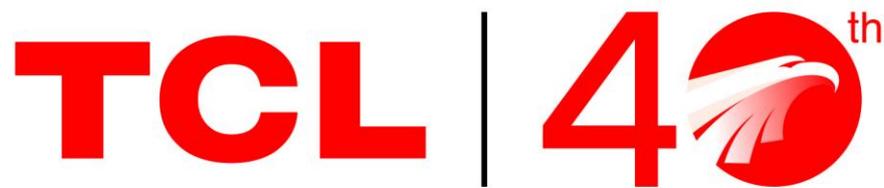
证券代码：000100

证券简称：TCL 科技

公告编号：2021-092

TCL 科技集团股份有限公司

TCL Technology Group Corporation



2021 年半年度报告摘要

二零二一年八月十日

一、重要提示

本半年度报告摘要来自半年度报告全文，为全面了解本公司的经营成果、财务状况及未来发展规划，投资者应当到证监会指定媒体仔细阅读半年度报告全文。

非标准审计意见提示

适用 不适用

董事会审议的报告期普通股利润分配预案或公积金转增股本预案

适用 不适用

公司计划不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本。

董事会决议通过的本报告期优先股利润分配预案

适用 不适用

二、公司基本情况

1、公司简介

股票简称	TCL 科技	股票代码	000100
股票上市交易所	深圳证券交易所		
联系人和联系方式	董事会秘书		
姓名	廖骞		
办公地址	广东省深圳市南山区 1001 号 TCL 科学园国际 E 城 G1 栋 10 楼		
电话	0755-3331 1666		
电子信箱	ir@tcl.com		

2、主要财务数据和财务指标

公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据

是 否

项目	本报告期	上年同期	本报告期比上年同期增减
营业收入（元）	74,298,646,758	29,333,210,856	153.29%
归属于上市公司股东的净利润（元）	6,783,884,807	1,208,065,986	461.55%
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润（元）	5,497,817,947	181,862,847	2923.06%
经营活动产生的现金流量净额（元）	13,895,714,157	7,347,810,779	89.11%
基本每股收益（元/股）	0.5026	0.0932	439.27%
稀释每股收益（元/股）	0.4835	0.0893	441.43%
加权平均净资产收益率	18.96%	4.11%	增加 14.85 个百分点
	本报告期末	上年度末	本报告期末比上年度末增减
总资产（元）	302,205,481,260	257,908,278,887	17.18%
归属于上市公司股东的净资产（元）	37,557,664,687	34,107,795,454	10.11%

3、公司股东数量及持股情况

单位：股

报告期末普通股股东总数	788,420	报告期末表决权恢复的优先股	-
-------------	---------	---------------	---

				股东总数（如有）		
前 10 名股东持股情况						
股东名称	股东性质	持股比例	持股数量	持有有限售条件的股份数量	质押、标记或冻结情况	
					股份状态	数量
李东生及其一致行动人	境内自然人/一般法人	8.26%	1,158,599,393	610,181,602	质押	72,000,000
					质押	344,899,521
惠州市投资控股有限公司	国有法人	5.30%	743,139,840			
武汉光谷产业投资有限公司	国有法人	3.65%	511,508,951	511,508,951	质押	255,754,475
香港中央结算有限公司	境外法人	3.26%	457,823,997			
中国证券金融股份有限公司	境内一般法人	2.66%	373,231,553			
西藏天丰企业管理有限公司	境内一般法人	1.75%	245,969,062			
信泰人寿保险股份有限公司—传统产品	基金、理财产品等	0.58%	81,958,072			
工银瑞信基金—农业银行—工银瑞信中证金融资产管理计划	基金、理财产品等	0.53%	74,761,500			
南方基金—农业银行—南方中证金融资产管理计划	基金、理财产品等	0.53%	74,761,500			
中欧基金—农业银行—中欧中证金融资产管理计划	基金、理财产品等	0.53%	74,761,500			
上述股东关联关系或一致行动的说明	李东生先生与新疆九天联成股权投资合伙企业（有限合伙）因签署《一致行动协议》成为一致行动人，合计持股 115,859.94 万股，为公司第一大股东。					
参与融资融券业务股东情况说明（如有）	公司股东西藏天丰企业管理有限公司除通过普通证券账户持有 163,223,537 股外，还通过信用证券账户持有 82,745,525 股，实际合计持有 245,969,062 股。					

4、控股股东或实际控制人变更情况

控股股东报告期内变更

适用 不适用

公司报告期控股股东未发生变更。

实际控制人报告期内变更

适用 不适用

公司报告期实际控制人未发生变更。

5、公司优先股股东总数及前 10 名优先股股东持股情况表

适用 不适用

公司报告期无优先股股东持股情况。

6、在半年度报告批准报出日存续的债券情况

√ 适用 □ 不适用

(1) 债券基本信息

债券名称	债券简称	债券代码	发行日	到期日	债券余额（万元）	利率
TCL 集团股份有限公司 2017 年面向合格投资者公开发行公司债券（第一期）	17TCL01	112518	2017 年 04 月 18 日	2022 年 04 月 19 日	100,000	3.40%
TCL 集团股份有限公司 2017 年面向合格投资者公开发行公司债券（第二期）	17TCL02	112542	2017 年 07 月 06 日	2022 年 07 月 07 日	15,700	3.45%
TCL 集团股份有限公司 2018 年面向合格投资者公开发行公司债券（第一期）	18TCL01	112717	2018 年 06 月 05 日	2023 年 06 月 06 日	17,001.9	4.00%
TCL 集团股份有限公司 2018 年面向合格投资者公开发行公司债券（第二期）	18TCL02	112747	2018 年 08 月 17 日	2023 年 08 月 20 日	200,000	5.30%
TCL 集团股份有限公司 2019 年面向合格投资者公开发行公司债券（第一期）	19TCL01	112905	2019 年 05 月 17 日	2024 年 05 月 20 日	100,000	4.33%
TCL 集团股份有限公司 2019 年面向合格投资者公开发行公司债券（第二期）	19TCL02	112938	2019 年 07 月 19 日	2024 年 07 月 23 日	100,000	4.30%
TCL 集团股份有限公司 2019 年面向合格投资者公开发行公司债券（第三	19TCL03	112983	2019 年 10 月 17 日	2024 年 10 月 21 日	200,000	4.20%

期)						
TCL 科技集团股份有限公司 2021 年面向专业投资者公开发行科技创新短期公司债券(第一期)	21TCLK1	149434	2021 年 03 月 25 日	2021 年 09 月 25 日	50,000	3.65%

(2) 截至报告期末的财务指标

项目	本报告期末	上年末	本报告期末比上年末增减
流动比率	105.64%	92.50%	13.14%
资产负债率	65.17%	65.08%	0.09%
速动比率	78.66%	66.36%	12.30%
	本报告期	上年同期	本报告期比上年同期增减
EBITDA 全部债务比	10.68%	5.12%	5.56%
利息保障倍数	5.12	1.22	319.02%
现金利息保障倍数	7.23	5.81	24.48%
EBITDA 利息保障倍数	8.55	3.93	117.66%
贷款偿还率	100%	100%	0.00
利息偿付率	100%	100%	0.00

上述会计数据和财务指标同比变动超过 30%的主要原因：报告期内，受益于行业景气上行、叠加公司自身产能高速增长及并购中环等因素，公司规模、经营业绩及盈利能力同比大幅上涨，从而造成公司会计数据及财务指标变动较大。

三、报告期内公司从事的主要业务

概述

新冠肺炎疫情尚未平息，地缘政治关系进入新格局，国际贸易摩擦对全球经济发展带来多重挑战，但由国际分工和比较优势决定生产要素配置、产业链和价值链分布的基础不会改变。中国已形成了完善的产业布局和供应链体系，复杂多变的内外环境将进一步坚定科技企业关键核心技术自主可控的战略方向，有助于加快基础、高端、核心技术攻坚，推进产业链和制造业升级，中国科技产业迎来新的发展机遇。

公司专注高科技、重资产、长周期的国家战略产业，聚焦于半导体显示、半导体光伏和半导体材料的核心主业发展。以运营和管理效率、产线代际以及规模效应驱动的半导体显示产业国别转移及头部集中趋势加速，中国企业竞争优势凸显，公司半导体显示业务开启从效率、产品到技术、生态的全面领先阶段。同时，通过持续变革创新、极致管理效率和全球化运营能力的赋能和支持，公司布局半导体光伏和半导体材料业务的产业新赛道成效显著，公司再次成功打造第二增长曲线。

报告期内，公司实现营业收入 743.0 亿元，同比增长 153.3%；实现净利润 92.5 亿元，同比增长 7.65 倍；归属于上市公司股东净利润 67.8 亿元，同比增长 461.5%；全面超额完成预算。其中：（1）受益于行业景气上行、叠加公司自身产能高速增长和产品结构改善等因素，公司半导体显示业务实现营业收入 408 亿元，同口径同比增长 93.6%，净利润 66.1 亿元，同比增长 67.5 亿元；（2）凭借技术积累、领先产能提升及供应链协同等优势，通过机制体制改革，组织活力激发，公司半导体光伏及半导体业务收入和利润同比大幅增长，中环半导体实现营业收入 176.4 亿元，同比增长 104.1%，实现净利润 18.9 亿元，同比增长 160.6%。

聚焦核心工艺、基础技术和新型材料研发投入，增强价值链关键环节和战略控制点的技术实力。报告期内，公司研发投入 50.9 亿元，占比营业收入达 7.0%，同比提升 76.9%，目前 PCT 专利申请量达 13,170 项，在量子点电致发光领域技术和材料专利申请数量达 1,480 件，位居世界第二。半导体显示领域，公司重点推进印刷 OLED/QLED、Mini-LED 及 Micro-LED 等新型显示技术的开发，实现下一代显示技术生态领先；半导体光伏及半导体材料领域，公司在 210 大硅片和叠瓦组件及相关技术生态领域已建立优势，4-12 英寸产品技术和生产工艺在国内领先。

产能进一步提升，规模优势增长，产品和客户结构不断优化。苏州华星 t10（原苏州三星液晶显示工厂）及配套模组厂（M10）于 4 月 1 日交割并表，超高清显示项目 t7 按计划爬坡，聚焦高端 IT 及商显领域的 t9 投建，半导体显示业务规模增速将保持业内最高。公司半导体光伏材料总产能达 70GW，其中 G12 产能达 39GW，宁夏中环六期项目 3 月已开工建设，天津和内蒙地区实施的钻石线切割超薄硅片智慧工厂项目投产顺利，江苏 G12 高效叠瓦组件项目实现产能 6GW，天津的 G12 高效叠瓦组件项目已进入建设阶段，半导体光伏产业链制造能力快速提升。公司将加大对中环领先内蒙古基地、天津基地和江苏基地的投资，推动对各类功率半导体芯片、集成电路芯片的全覆盖；此外，为强化产业链协同效应，公司已投资设立半导体投资和运营平台，围绕半导体集成电路等相关领域寻找产业投资布局机会。

公司具备全球化的供应链管理体系和运营能力。公司已在供应链管理、知识产权保护、风险控制与合规运营等方面具备全球化统筹管理能力。印度华星工厂目前规划产能为大尺寸显示模组 800 万台，中小尺寸显示模组 3000 万台，可满足战略客户的本土配套需求；公司旗下茂佳科技在墨西哥已建立整机及模组供应能力；中环半导体已在欧洲和墨西哥设立组件工厂，在马来西亚、菲律宾、新加坡布局电池产能。

加速数字化转型，继续推进极致成本效率与敏捷制造的升级。公司持续深耕智能制造和工业 4.0 领域，已将 TCL 华星打造成智能工厂样本，构建了行业内首个工业互联整体解决方案；中环半导体的工业 4.0 智慧工厂，继续推动数字化、智能化转型升级。

今年是 TCL 成立四十周年，40 年来，TCL 始终坚守实业，迎接变化挑战，从加工贸易、终端生产到显示器件制造、新能源和核心材料布局，一路沿着电子产业链逆流而上。公司在 2009 年进入半导体显示产业，逐步确立了 TCL 华星效率效益和规模效应的领先优势；2020 年，公司通过摘牌中环电子布局半导体光伏和半导体材料赛道，明确了协同两大核心产业迈向全球领先科技集团的战略方向。随着在领先技术、先进工艺、财务底蕴的积累逐渐深厚，公司亦将完成从跟随者往领先者的转型，以更坚实的基础引领中国科技产业走向全球生态领先。

展望未来，半导体显示行业供需关系改善及头部集中的本质不变，行业周期性弱化趋势明确，TCL 华星的相对竞争优势将进一步加强；清洁能源提质增效的全球共识，驱动半导体光伏行业高速增长；中国半导体产业加速发展，历史机遇与挑战并存。公司将在半导体显示、半导体光伏及半导体材料领域打造战略控制点，坚持“经营提质增效，锻长板补短板，加快全球布局，创新驱动发展”的经营策略，不断提高竞争力，持续健康发展，做到全球行业领先。

主营业务经营情况

公司主要业务架构为半导体显示业务、半导体光伏及半导体材料业务、产业金融及投资平台和其他业务。公司将继续优化业务结构，进一步聚焦资源于主业发展，实现半导体显示、半导体光伏及半导体材料两大核心产业全球领先的战略目标。



（一）半导体显示业务

半导体显示产业供需关系改善，行业集中度提升，产品价格持续上涨，行业整体盈利能力持续提升。**TCL 华星作为半导体显示行业的头部企业，充分受益于行业景气度上行，同时通过内生增长及外延并购持续扩大规模，效率效益保持全球行业领先。**报告期内，TCL 华星实现销售面积 1,779.2 万平方米，同比增长 25.3%，半导体显示业务实现营业收入 408 亿元，同口径同比增长 93.6%，净利润 66.1 亿元，同比增长 67.5 亿元，其中 2021 年第二季度实现净利润 42.1 亿元，环比第一季度增长 76%。

大尺寸业务规模优势扩大，产品结构继续丰富。t1、t2 和 t6 工厂保持满销满产，t7 工厂按计划爬坡，t10（原苏州三星液晶显示工厂）于二季度开始并表，公司在 TV 面板市场份额全球第二，55 吋产品份额全球第一，65 吋和 75 吋产品份额全球第二，32 吋产品份额全球第三，在 8K 和 120HZ 高端电视面板市场份额跃居全球第一；公司把握商用显示市场快速增长机遇，交互白板、拼接屏、广告机等市场份额快速提升，其中交互白板出货量全球第一。报告期内，大尺寸产品结构进一步优化，非 TV 屏营收占比从 16% 提升至 22%；客户组合进一步优化。

小尺寸业务技术能力提升，产品和客户结构优化。t3 LTPS 产线持续优化产品组合，提升产品竞争力，并加速中尺寸产品开发和导入，笔电、车载、平板等中尺寸出货占比提升至 23%，LTPS 手机面板出货量维持全球前四。t4 柔性 AMOLED 产线一期满产，二期和三期设备完成搬入，通过折叠、屏下摄像、LTPO 等差异化技术储备，在高端市场加快产品开发和客户合作，出货量实现同比翻倍以上增长。

中尺寸业务在高端细分市场快速成长，产能加快建设。公司通过在现有产线上的产能调整，加快中尺寸战略布局，建立核心客户合作基础。在显示器市场聚焦高端电竞产品，市场份额全球第二，LTPS 笔电面板出货量全球第二，LTPS 平板面板出货量提升至全球第一，车载导入多家国内外头部客户，出货量快速提升。为满足客户需求，解决 IT 产品产能瓶颈，公司已投建第 8.6 代氧化物半导体新型显示器件生产线 t9 项目，预计 2023 年投产。

报告期内，半导体显示业务业绩构成如下表：

项目	出货面积		出货数量		收入		净利润	
	万平米	同比%	万片/万台	同比%	亿元	同比%	亿元	同比%
大尺寸	1698.8	24.3%	2776.6	20.0%	282.0	131.9%	71.7	1384.6%
中小尺寸	80.4	51.1%	4898.7	25.4%	106.4	44.7%	-3.5	减亏 0.2 亿
茂佳科技（注）	-	-	229.3	-2.1%	35.6	38.1%	1.1	增加 1.2 亿
其他及抵消	-	-	-	-	(16.4)	-	(3.1)	-
合计	-	-	-	-	408	93.6%	66.1	增加 67.5 亿

注：茂佳科技出货数量、收入和净利润为 2021 年二季度数据，同比数据为备考口径，包含茂佳科技 2020 年 Q2 数据。

展望未来，半导体显示产业长期发展前景趋好。LCD 显示产业产能向中国大陆头部企业高度集中，头部企业在管理效率、规模、技术、成本、供应链等方面具备显著优势，行业进入壁垒大幅提高；TV、IT 及手机等传统显示需求保持平稳增长，商用显示、车载显示等新兴显示快速发展，下半年大尺寸需求增长减缓，但长期看 LCD 行业供需将走向动态平衡。TCL 华星将保持营收持续增长，巩固高效率运营和经营效益

优势。TCL 华星在 OLED 产业领域依然面临巨大挑战，上半年公司集中力量重点突破产品技术瓶颈，满足战略客户交付，并在折叠屏等关键技术取得突破；预期下半年销量可持续增长，逐步改善经营效益。

在行业格局逐步稳定的背景下，TCL 华星的产能增长和结构优化将是未来业绩增长的主要驱动力，公司将围绕“优化产线结构和产品结构、提升客户组合、完善产业生态”，加快从大尺寸显示产业全球领先向全尺寸显示产业全球领先的升级。

TCL 华星产能和收入将继续高速增长。公司从 2020 年 3 条高世代线（2 条 G8.5，1 条 G11）发展至今年底的 4.5 条（t10 已并表、t7 一期完成爬坡），至 2025 年将具备 6 条高世代线（t7 和 t9 达产），未来 5 年 TCL 华星高世代线产能复合增速超过 18%。同时，t4 柔性 OLED 产线从一期到三期的满产也将带来显著的收入增长。公司收购的苏州三星模组厂和提供模组整机一体化制造的茂佳科技，将推动公司价值链向下游延伸。

TCL 华星业务和产品结构将不断优化。随着中尺寸产能的补足，TCL 华星将形成大、中、小全尺寸业务布局，业务和收入结构更加均衡，带来更高的单位面积产值和收入增速。TCL 华星将坚持高端产品战略，充分发挥华星 HVA 技术和高世代产线优势，深化与全球头部品牌客户的合作，在超大尺寸、8K、120HZ、曲面等高端市场持续提升份额，深化高质量增长。

TCL 华星将发挥管理优势保持效率效益业内领先。通过极致管理能力和产业协同优势，TCL 华星自投产以来始终保持行业领先的盈利水平。随着产能扩大和产线丰富，公司将积极调整产线产品布局策略，充分发挥各产线优势，降低产线产能折损；加强数字化和智能化运营，提升智能制造能力，提升全产业链的运作效率；发挥规模效应，完善供应商资源整合和产业链布局，打造更具弹性和成本竞争力的供应链。随着既有产线折旧陆续到期，预计折旧占收入的比例将逐步下降，华星盈利能力将进一步提升。

TCL 华星将持续加强技术创新，成为新型显示技术引领者。TCL 华星通过旗下“国家印刷及柔性显示创新中心”——广东聚华及战略入股的 JOLED，加速印刷显示工艺的量产技术研发，通过华睿光电积极推进自主 IP 的 OLED 和 QLED 材料开发，完善印刷显示生态建设。同时，公司以股权投资、战略合作等方式，与产业链合作伙伴共同推动在 Mini-LED、Micro-LED 等新显示技术的发展，引领未来技术发展趋势。

（二）半导体光伏及半导体材料业务

全球资源消耗和生态环境问题日益突出，国家“十四五”规划纲要明确提出碳达峰、碳中和目标，清洁能源产业已进入高速增长时期。但随着新冠肺炎疫情逐渐可控，全球经济复苏预期不断加强，工业产品需求旺盛推高大宗原材料价格，供应链和成本管理能力对企业带来挑战。面对外部环境波动，中环半导体通过产品技术提升和产能扩充、供应链资源整合、管理效率提升和制造方式转型，经营提质增效，全面提升企业竞争力，坚定迈向光伏产业全球领先、半导体硅片产业中国领先的战略目标。报告期内，中环半导体实现营业总收入 176.4 亿元，同比增长 104.1%，净利润 18.9 亿元，同比增长 160.6%。

1、半导体光伏产业领域

上半年，光伏产业迎来高速发展，公司积累的技术优势显现，产品结构转型顺利，产能规模不断提升，并继续以技术创新、工艺技改及各作业场景的工业 4.0 应用，提高资产运营效率和产线投资收益。同时，中环半导体通过长期构建的战略供应链协同合作，有效应对多晶硅原料供需紧张和价格短期快速上涨的压力，完善材料储供体系，强化外部风险应对能力，保障产品盈利稳定增长。报告期内，半导体光伏业务实现营收 165.3 亿，同比增长 106.9%。

在半导体光伏材料端，中环半导体继续推进 210 产品产销规模和产品质量提升，协同产业链上下游的生态体系，有效满足光伏全产业链效益需求。报告期末，公司半导体光伏材料产能较 2020 年末提升超过 5

5%至 70GW（其中 G12 产能占比约 56%），市占率持续提升。报告期内，通过工艺技术优化，单位产品硅料消耗率同比下降近 2%，硅片 A 品率大幅提升，单位产品毛利率同环比继续提高，盈利能力持续提升。

在半导体光伏组件端，公司继续围绕叠瓦组件研发与国内领先 G12 PERC 电池制造商协同创新，同时施行差异化竞争策略，以“G12+叠瓦”技术推进大尺寸高功率组件扩张，提升国内外订单落地能力，江苏地区 G12 高效叠瓦组件项目产能实现 6GW；天津投建的 G12 高效叠瓦组件项目已正式进入土建阶段，设备同步入场，整体产能规模稳步提升。

公司全球化布局完善，品牌效益初现，海外业务显著增长，硅片外销份额全球第一。公司旗下 Maxeon 于北美市场拓展顺利，上半年斩获 Primergy 公司 GW 级高效太阳能组件订单。未来，公司将在全球范围内进一步拓展电池、组件的制造体系和地面式电站、分布式电站业务。

2、半导体材料产业领域

疫情常态化趋势下，全球工业、汽车、消费电子等需求强劲复苏，叠加多种新兴芯片应用需求爆发，芯片短缺问题持续发酵，带动上游半导体材料价格大幅上涨。在关键材料短缺背景下，国产半导体材料下游客户导入进度明显加快，国内半导体材料企业亦获得长足的市场替代空间。

报告期内，公司把握行业上行及国内市场替代机遇，半导体材料产品验证和客户开发加速，获得全球主要客户认可，产销规模迅速扩大，收入同比增长 65.8%。目前公司已投入产线均已实现满产，报告期内，6 英寸产品增加 EPI 路线并开始策划终端客户认证，8 英寸产品国内客户 Logic、CIS 等产品持续认证增量，国际客户新产品认证加速，12 英寸产品全面对标国际领先产品，产品性能及质量获国内外头部客户高度肯定。

公司按照“9205”既定战略规划，加速产能扩张，加快各尺寸产品领域的业务拓展，天津、宜兴工厂新增投资项目顺利开展，为半导体业务加速发展奠定基础。公司在巩固传统功率半导体产品优势的基础上，已成为数字逻辑产品和存储产品的有力参与者。

（三）产业金融及投资业务

报告期内，公司财资业务着力保障公司项目资金需求，同时进一步提升对产业资金和风险的主动管理能力，极致降本增效，管控企业应收和外汇风险，支持公司核心主业迈向全球领先。

TCL 资本在新型显示、半导体及相关产业链核心材料和工艺设备等驱动科技产业发展的关键领域发掘投资布局的机会，推进技术业务协同，兼创投资收益。报告期末，TCL 创投管理的基金规模约为 92 亿元人民币，累计投资 116 个项目，目前持有宁德时代、帝科股份、寒武纪、新致软件、Innoviz、百勤油服、中嘉博创、海联金汇等上市公司股票；钟港资本投资银行和资产管理业务平稳增长，报告期内完成 13 个资本市场和财务顾问项目，并获批准成为欧洲清算银行成员，可以从事相关国际证券清算和托管业务，业务范围进一步多元化拓展；中新融创继续聚焦于公司两大核心主业的产业链布局机会，累计投资上市公司超 132 家，业绩稳健增长。

四、重要事项

详见公司2021年半年度报告全文。